**苏州国芯科技股份有限公司**

**2024年2月29日至3月1日投资者关系活动记录表**

**证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-004**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 银河基金；长盛基金；嘉合基金；创金合信基金；申万宏源证券；民生证券；德邦证券；华能贵诚信托；华泰资产；阳光资产；人寿养老；深圳福鸿达投资；鹤禧投资；北京衍航投资；上海肇万资产 |
| **时间** | 2024年2月29日13:30；2024年2月29日14:30；2024年3月1日13:30 |
| **地点** | 上海锦江汤臣洲际大酒店会议室；无锡君来世尊酒店会议室 |
| **上市公司参加人员姓名** | 证券事务代表：龚小刚先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。投资者提问的问题主要如下：**   1. 请介绍一下公司汽车电子芯片的研发进展情况？   答：2023年，公司为大力发展汽车电子芯片和面向服务器的高可靠存储控制芯片，持续较大规模投入产品与技术研发，研发费用比上年增长85.36%，其中主要增长是用于汽车电子芯片的研发。公司在汽车电子芯片领域陆续推出了中高端汽车电子MCU芯片CCFC3007PT和CCFC3008PT、汽车电子PSI5收发器专用芯片CIP4100B、安全气囊点火驱动专用芯片CCL1600B、汽车智能座舱音响和主动降噪DSP芯片CCD5001等新产品。汽车电子芯片均按照汽车电子等级进行设计和生产，具备可靠性与功能安全性。  公司今年还将有更多在研的高端产品MCU、SOC推出面向市场，目前在研的重要产品包括多核高性能汽车电子MCU（用于高端的动力控制和域控制等）CCFC3012PT、底盘驱动芯片CCL2200B、智能传感芯片CMA2100B、门控专用芯片CCL1100B芯片、无刷电机控制CBC2100B和NFC射频收发CN7160芯片等。值得一提的是，正在开发的CCFC3009PT芯片是面向辅助驾驶领域和滑板底盘应用而设计开发的MCU芯片，采用高性能 RSIC-V 架构 （6个主核+4 个锁步核），算力更高可达到6000DMIPS以上。  公司目前在汽车电子芯片领域已经建立起较为丰富完整的产品线，未来还将不断推出面向市场的新产品，持续突破在汽车电子等关键领域的市场和技术壁垒，积极开拓市场和客户。  **2、公司的云安全芯片产品是否有新的进展？**  答：公司围绕自主云安全芯片持续进行新一代产品技术研发，对已有自主云安全芯片与应用进行技术升级迭代，公司已立项开发融合了神经网络计算NPU技术的新一代云安全超高速加解密芯片，其加密模块SM2签名性能可达100万次/秒，SM4加密性能可达80Gbps/秒，性能提升达到数倍，可满足超高端云安全应用需求，目前相关产品正在积极研发过程中。  **3、截止2023年底，公司已经实现量产出货的车规级芯片产品都有哪些？**  答：公司目前已量产的汽车电子芯片应用领域涵盖车身与网关控制、安全气囊、线控底盘、域控制器、车联网安全、动力总成、仪表等，在安全气囊控制、车身控制等应用型号都超过50万颗，特别是在安全气囊控制方面型号产品已经销售超过200万颗。  **4、请介绍一下公司在量子芯片的布局情况？**  答：信创和信息安全是公司业务的重要组成部分，公司持续采用量子技术对信创和信息安全芯片产品进行升级，提升并拓展公司信创和信息安全产品线。2022年，公司与硅臻首次合作，成功研发了基于国芯科技CCP903T高性能密码芯片和硅臻QRNG25SPI量子随机数发生器模组的高速量子密码卡，可广泛应用于密码机、签名/验证服务器、安全网关/防火墙等安全设备以及金融、物联网、工业控制、可信计算和国家重大需求等领域。2023年，公司与问天量子、文芯科技签署了战略合作协议，三方合作成立量子芯片联合实验室，面向互联网、物联网、人工智能、云计算、先进存储和通信基础设施等领域，共同研发应用于云-边-端的量子密码芯片；并针对上述应用场景，开发量子信息安全方案、技术及产品。近日，公司与硅臻签署了战略合作协议，双方将组建智能终端量子安全芯片联合实验室，基于公司的ET系列智能终端信息安全芯片和硅臻的QRNG-10量子随机数发生器芯片联合发展智能终端量子安全芯片技术和产品。硅臻同时也是公司的参股企业。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年3月 |